

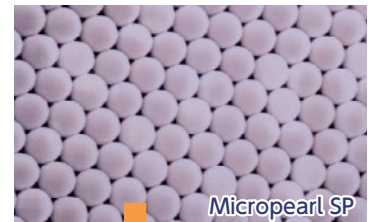
均一な粒子径分布の金属被覆プラスチック粒子
Plastic core conductive particle having uniform size distribution

電子部品と基板間の導通、熱伝導、ギャップ形成などに利用可能

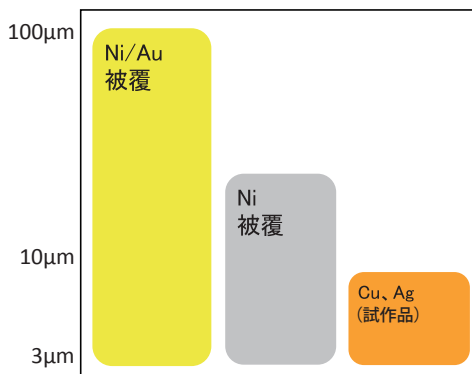
Available for several usage for conduction and heat conduction gap control between electronic device and base board and so on

特徴 Features

- 1 均一な粒子径分布を有するプラスチック微粒子表面に金属層を均一に形成
Metal plated plastic core particle having uniform size distribution
- 2 様々な種類の金属層の形成が可能 (Au, Ni, Cu, Ag等)
The formation of various types of metal layers is possible (Au, Ni, Cu, Ag etc.)
- 3 独自のポリマー設計技術により、粒子硬さ・反発力の制御が可能
By the original polymer design technology, the control of particle hardness and repulsion is possible.

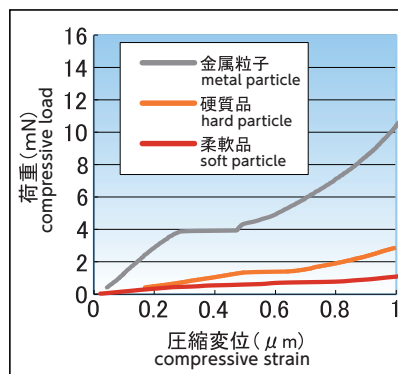


粒子ラインナップ Line up



豊富な粒子径、金属種をラインナップしています。
variable diameter and metals

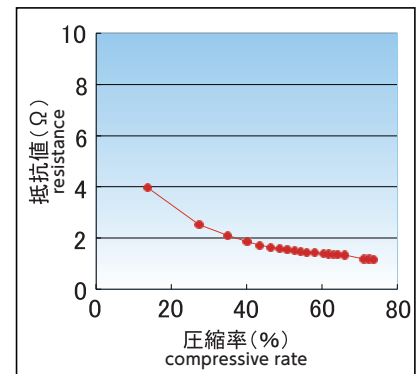
硬さ評価データ hardness data



3 μm Ni/Au被覆粒子データ

金属粒子より柔軟な特性を有しています。
soft modulus than metal particles

抵抗値評価データ resistivity data



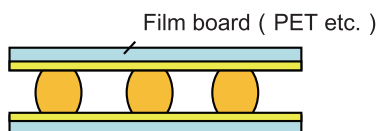
3 μm Ni/Au被覆柔軟品データ

柔軟な特性により圧縮変形し抵抗値低減します。
low resistivity by soft modulus

用途例 Application

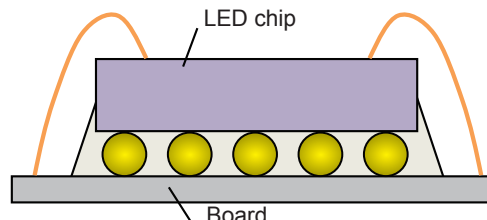
- 1 フレキシブル基板同士の導通用途
フレキシブルディスプレイ
色素増感太陽電池 等

Conductive materials between the film boards
Flexible display, Dye-sensitization solar cell etc.



- 2 パワー半導体、LEDチップと基板間のギャップ制御材料

Gap control materials between a LED chip or a power semiconductor and the board



- 3 圧電変換素子用途

The piezoelectric element use

